

2024年2月13日

各位

第31回芦原科学賞「芦原科学大賞」を受賞

四国化成ホールディングス㈱のグループ会社である四国化成工業㈱〔本社：香川県丸亀市、代表取締役社長：濱崎誠〕はこの度、香川県内の優れた産業技術を表彰する第31回芦原科学賞において「芦原科学大賞」を受賞しました。

受賞したのは、スマートフォン・半導体機器の高機能化に貢献する新規樹脂硬化剤（製品名：TS-G）の開発に携わった7名の社員です。

〔受賞者：熊野 岳（くまの たけし）・松田 晃和（まつだ あきかず）・武田 琢磨（たけだ たくま）・奥村 尚登（おくむら なおと）・藤川 和之（ふじかわ かずゆき）・青木 和徳（あおき かずのり）・荒井 利将（あらい としまさ）〕

新規樹脂硬化剤（製品名：TS-G）は、電子材料用高機能接着剤の原材料としてスマートフォンや半導体機器等の様々な最先端用途で採用されています。「低温条件で硬化・成形できる」、「耐熱性と耐湿性に優れている」という、これまで実現が難しかった2つの条件を両立させました。硬化・成形条件の低温化は、成型時のエネルギー効率改善により環境負荷を低減することができ、150℃以上の高温条件下では変形・不具合が発生してしまう電子部品を搭載可能にしたため、様々な最先端機器の高性能化に大きく貢献しました。2014年の上市以降から現在まで適用用途が拡大しており、今後も継続的な売り上げの増加が期待できます。

芦原科学賞は、高松市出身の関西電力名誉会長 故・芦原義重氏の寄付金を基金として、公益財団法人かがわ産業支援財団が県内の産業技術の高度化及び産業の振興に寄与することを目的に、自然科学分野において優秀な研究成果をあげた個人や団体を表彰するものです。当社が芦原科学大賞を受賞するのは、1995年度における「プリント配線板用回路防錆剤「タフエース」の開発」に続き、2度目となります。

贈呈式は、2月29日(木)午後4時から高松国際ホテルで行われます。

以上

このリリースに関するお問い合わせは
四国化成ホールディングス㈱ 経営企画室 広報課まで
TEL. 0877-21-4119